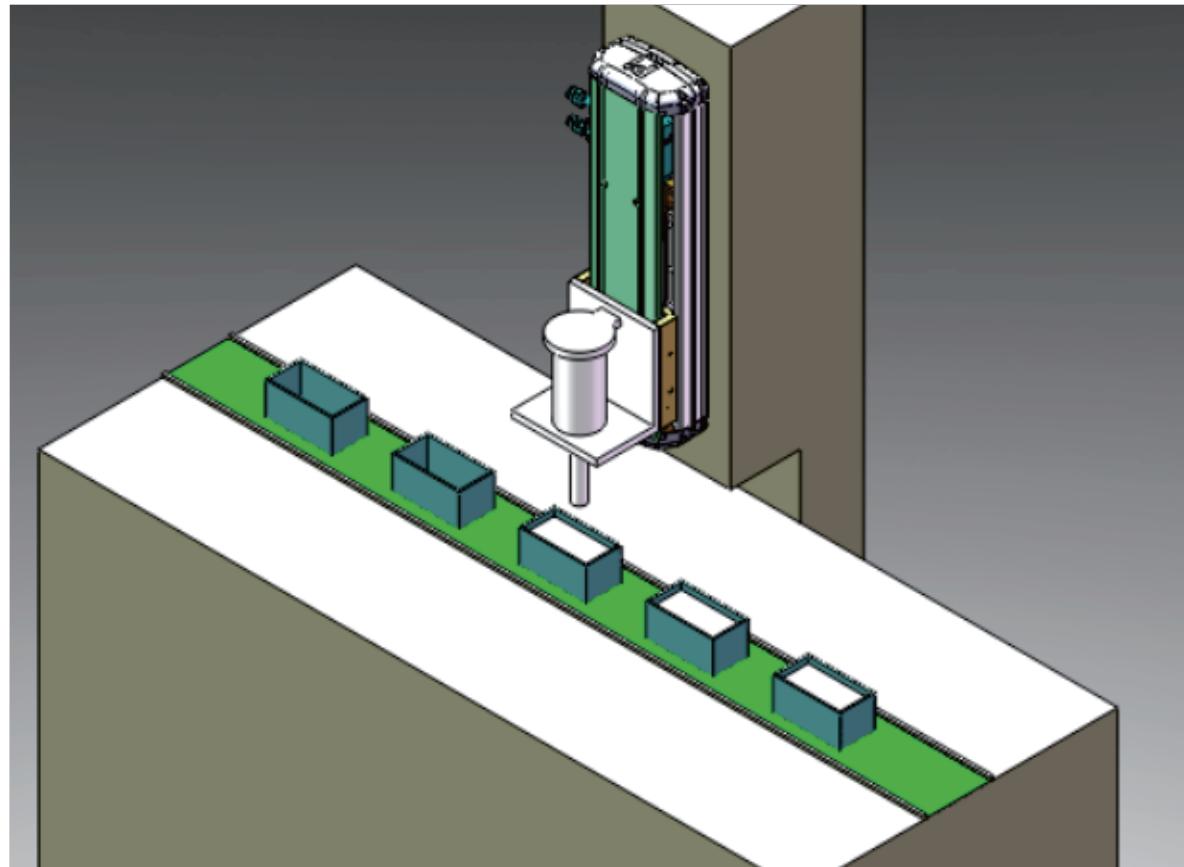


半导体 / 封装 / 测试

用途 充填装置



说明

为了因应不同品的充填作业，利用滑台可程式化的特性，可于不同高度的位置，执行充填作业。